

PCB 焊接	产品名称	产品型号	工序	文件编号	版本	页数	制订时间
工艺要求	直流伺服	MDC-4D_CON_V1.0	焊接	QM0332025070401	V1	1/1	20250704

焊接要求

1. LED 指示灯焊接高度

D16, D14, D30, D46, D62, LED 两个管脚套上 LED 间隔柱 4*11.5, 压到底再进行焊接 (见图 1)
焊接后的 LED 板上总高度控制在 16.5~17mm

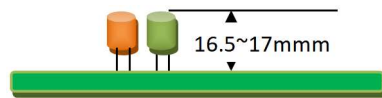


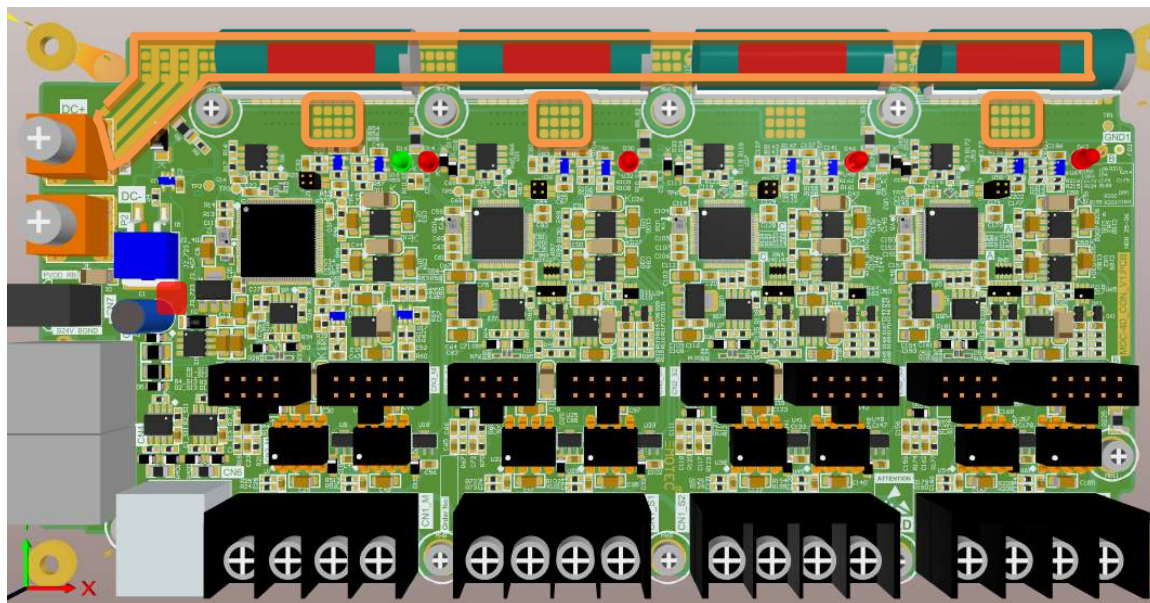
图 1

2. 加锡

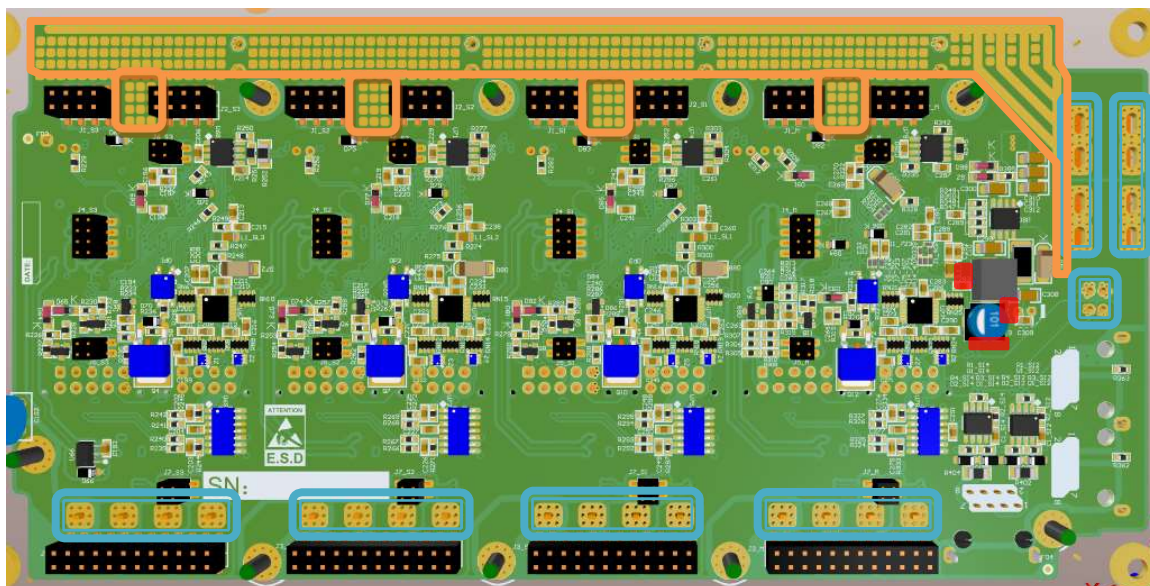
- 蓝色双线框内半透明覆盖的 PAD 区, 要求每个通孔注满焊锡, 管脚上下焊接为锥面 (锡量不要过多堆砌)
- 框内 PAD 加锡, 加锡厚度为 0.2mm 【※卧式电解 C21, C70, C115, C160 下方的焊盘不加锡】

3. 点胶

电解电容 [C21, C70, C115, C160] 管脚折弯 90 度焊接 (注意极性), 其与 PCB 接触面 (电解下面) 红色半透明色块区域为点胶位置分布图, 以及 C1 及底层的电感 L9, L10 点固定胶 (黑色 704 固定胶), 点胶厚度为 1.5mm;



电解下表面点胶



- 2. 所有排针排母焊接, 需要压到底焊接, 不接受歪扭, 偏差要小于 0.3mm;
- 3. 未特殊说明的参见《IPC-A-610E 电子组件的可接受性》标准;

编制		审核		批准	
日期		日期		日期	